

2012年5月9日

各位

日本ゼオン株式会社

日本ゼオンとIBM、高速シリアル伝送技術に関する共同開発を発表

日本ゼオン株式会社(本社:東京都千代田区、社長:古河 直純)は、International Business Machines Corporation(本社:米国ニューヨーク州アーモンク、CEO:バージニア・M・ロメッティ、以下IBM)との間で、次世代メインフレームコンピューター向けの高速シリアルリンク(*1)(>25Gbps)を達成すべく、新規プリント配線板の共同研究開発に合意したと発表した。

近年、インターネットを中心としたデータ通信がクラウドコンピューティングを介して利用されるようになってきており、その中枢を担うメインフレームコンピューターは、スマートフォンに代表される携帯情報端末の急速な普及や、フェイスブックやツイッターのようなSNSを中心としたインターネット利用環境の変化により、ますます高い情報処理能力を求められるようになってきている。

日本ゼオンは、次世代メインフレームコンピューターを主要ターゲットとした新規プリント配線板用絶縁材料(ZEONIF™ XL-Series)の開発を進めており、革新的技術でメインフレームコンピューター市場を牽引しているIBMとの共同開発を推進することにより、次世代の高速シリアルリンクに求められる高い技術障壁のブレイクスルーが可能になると期待される。

日本ゼオンは技術者を米国ニューヨーク州のYorktown HeightsにあるIBMのThomas J. Watson研究所に派遣し、共同開発を進めていく。

(*1)高速シリアルリンク:伝送路上を一度に1ビットずつ、逐次的にデータを送る方式であり、現状の速度は10Gbps以下である。

お問い合わせ先

日本ゼオン株式会社

CSR 統括部門 広報室

電話 03-3216-2747

The logo for ZEON, consisting of the word "ZEON" in a bold, blue, sans-serif font.